



受控编号: NC04-0067

检测报告

Test Report

产品名称

Name of product

DBC

型号规格

Model Type

氮化铝基片

报告编号

Report number

WEEN20230329011

委托单位

Consigner

上海铠琪科技有限公司

检测类别

Test Type



瑞能半导体有限公司实验中心

WeEn Semiconductors Co., Ltd. Experiment Centre



申 明

1. 本检验报告（包括复制件）未加盖本中心印章无效。
2. 本检验报告无检验、审核、批准人员签署无效。
3. 客户需要复制本检验报告时，请持公函或单位介绍信到本中心办理。
4. 本检验报告涂改无效。
5. 除特别声明外，本检验报告仅对来样负责。
6. 客户如果对本检验报告有异议，应在收到报告之日起十五日内以书面方式向本检测站提出。

瑞能半导体有限公司实验中心

地 址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区尚荣医疗健康产业园 C4

邮政编码：320200

电 话：0791-85952928



检测报告总结

委托信息	单位名称	上海铠琪科技有限公司				
	委托人	部门	/	电话	18701698595	
	地址	上海市嘉定区嘉定镇博乐路 70 号 36 幢 4 层 J				
	委托单号	FA230206ES-3	检测目的	鉴定产品 TC 100cycles 试验后是否有分层		
检测样品信息	样品名称	氮化铝基片	样品型号	2725-B	检测总数量	5 片
	收样日期	2023-3-22		生产日期或批号	/	
	峰值耐压	/	最大触发电流	/	通态电压	/
检测项目与检测方法标准	检测项目名称	样品数量	检测方法标准			
	超声波扫描检测	5 片	IPC JEDEC J-STD-035-1999(R 2010) 非气密性封装元器件声学显微镜检测方法			
	温度循环	5 片	GJB 548B-2005 微电子器件试验方法和程序, 方法 1010			
检测开始日期	2023-3-22		检测结束日期:	2023-3-28		
检测结果	TC 100cycles 试验后无分层					
检测场地	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区尚荣医疗健康产业园 C4					

三: 除全文复制外, 未经实验室批准本报告不得部分复制。

编制人 (Editor): 周训斌

签名: 周训斌

日期: 2023.4.4

审核人 (Reviewer): 刘佳

签名: 刘佳

日期: 2023.4.4

批准人 (Approver): 李函

签名: 李函

日期: 2023.4.4





1. 检测设备清单:

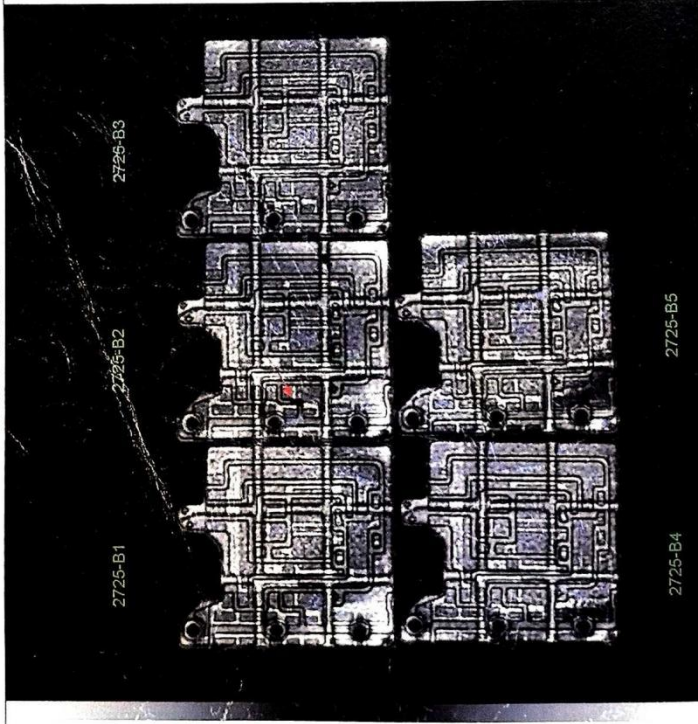
试验仪器设备	设备型号	设备编号	能力范围	设备校准日期
超声波扫描仪	SONOSCAN D9600	SAM01#	15-100MHZ	/
温度循环(气体)	VOTSCH VT3 7012	AT02#	高温: $\leq 200^{\circ}\text{C}$, 低温 $\geq -80^{\circ}\text{C}$	2024-3-7





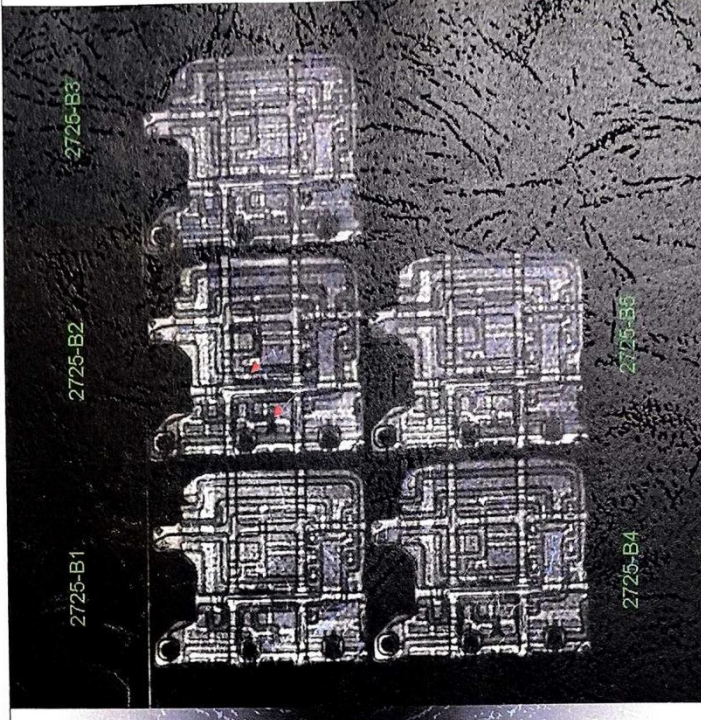
2725-B SAM before TC

T-mode of whole DBC



2725-B SAM after TC

T-mode of whole DBC



结果: 2725-B C-mode before TC and after TC: 无分层 (红色箭头标示区域为 PCB 槽)

———报告结束———



2.1 超声波扫描显微镜检测

委托单号	FA230206ES-3	产品型号	2725-B
检测数量	5 片	封装类型	/
样品编号说明	按客户要求编号(客户无要求时执行随机编号)		
检测开始日期	2023 年 3 月 22 日	检测结束日期	2023 年 3 月 28 日
检测结论	TC 100cycles 试验后无分层		

2.1.1 样品图片;

2725-B





2.2 温度循环试验条件

-65° C(15min) to +150° C(15min) 100 cycles

2.3 超声波扫描显微镜检测结果



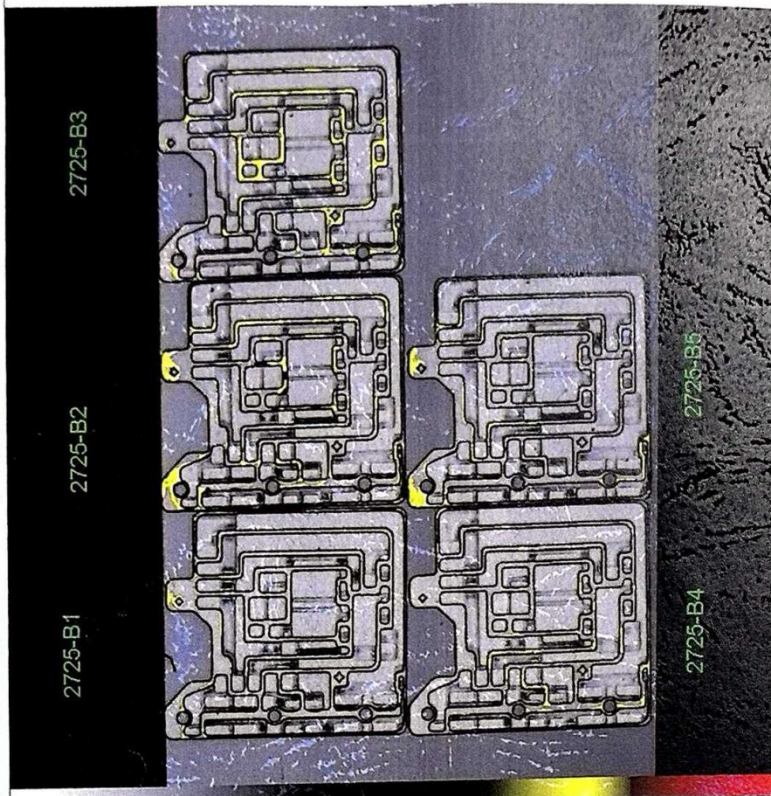
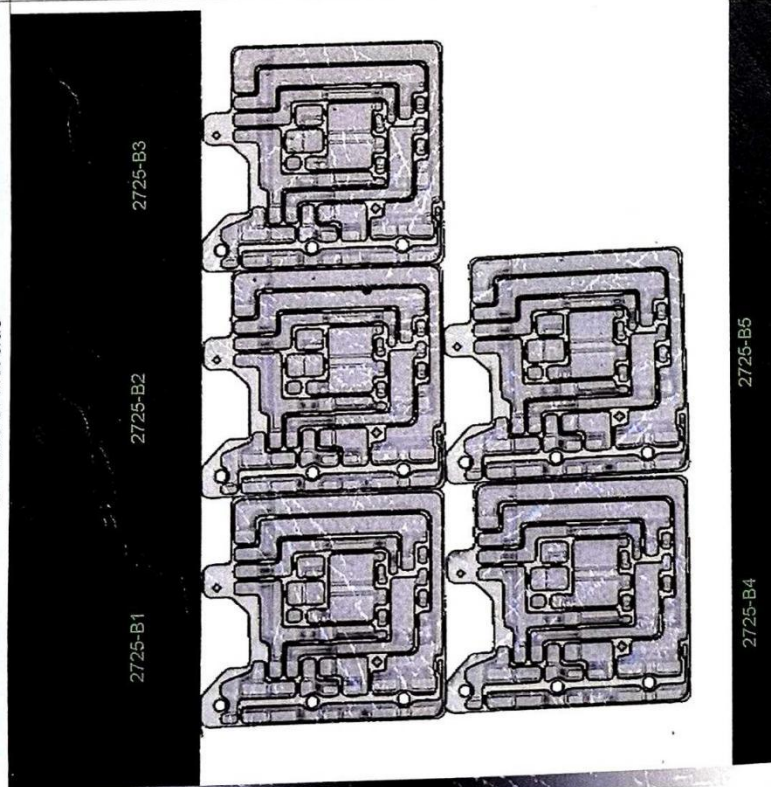


2725-B SAM before TC

2725-B SAM after TC

C-mode of first side

C-mode of first side



结果: 2725-B C-mode before TC and after TC: 无分层 (黄色区域为干扰)



检测项目测试数据目录

1. 检测设备清单	5
2. 检测项目	6
2.1 超声波扫描显微检测	6
2.2 温度循环试验	7
2.3 超声波扫描显微检测数据	8

结果: 2725-B C-mode before TC and after TC: 无分层 (黄色区域为干扰)

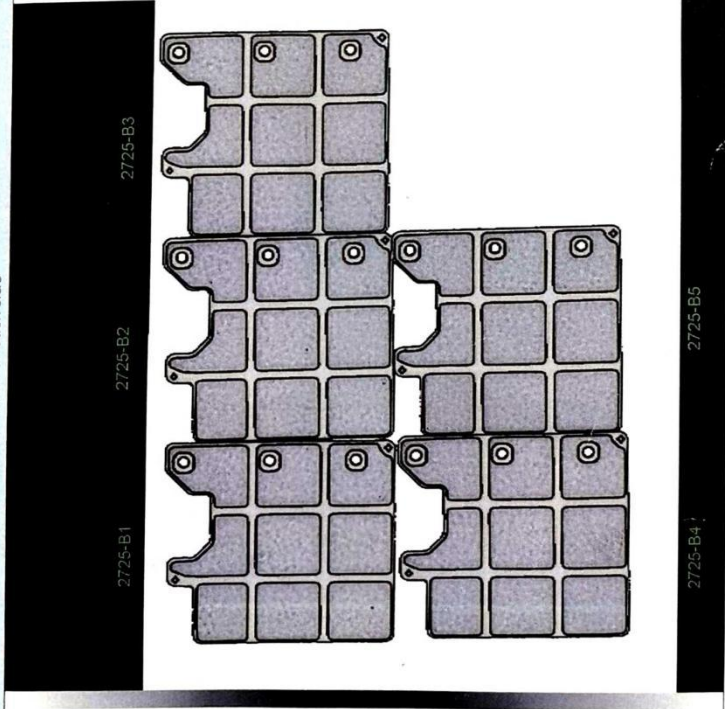


瑞能半导体科技股份有限公司实验中心

报告编号: WEEN20230329011 第 9 页/共 10 页

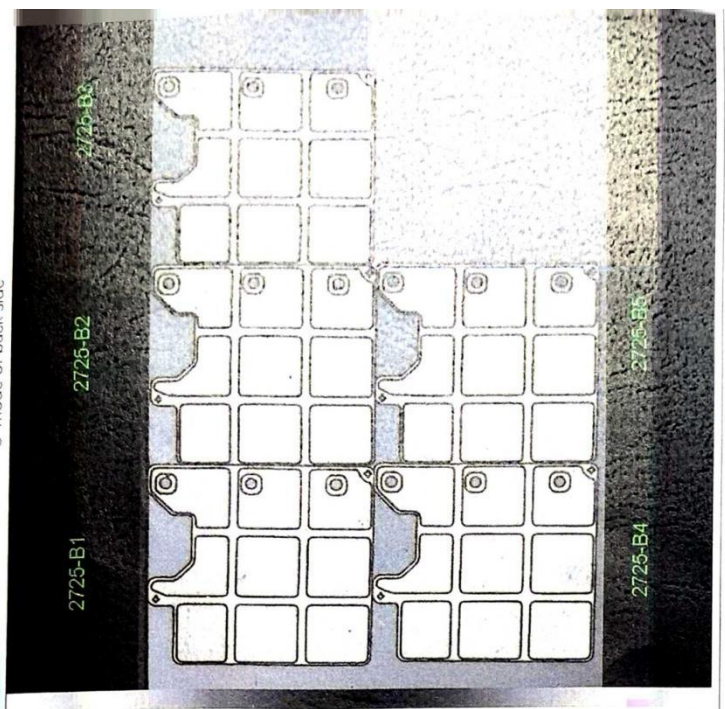
2725-B SAM before TC

C-mode of back side



2725-B SAM after TC

C-mode of back side



结果: 2725-B C-mode before TC and after TC: 无分层 (黄色区域为干扰)

2023.4.1